

御客様各位

# 第47回ネコンジャパン（プリント配線板 EXPO） 出展のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は、このたび東京ビッグサイトにて開催されます  
「ネコン ジャパン（プリント配線板 EXPO）」に昨年に引き続き、  
出展する運びとなりました。  
ご多忙の中、誠に恐縮ではございますが、ご招待券を同封致しますので、  
是非この機会にご来場賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

- 記 -

☆ 会期：2018年1月17日（水）～19日（金） 10:00～18:00  
19日（金）のみ17:00終了

☆ 会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東2ホール E17-9）

☆ 出展内容：LCPモジュール基板（リジッド・フレキ）、熱流センサ Energy Eye



**弊社ブース  
東2ホール  
ブース番号 E17-9**

【お問合せ先】

株式会社デンソー 阿久比製作所  
生産技術研究部 PALAP事業プロジェクト室  
矢崎 芳太郎

〒470-2298 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1  
TEL : 0569-49-1145 FAX : 0569-49-1088  
E-mail : yoshitaro\_yazaki@denso.co.jp